

2016年5月23日

グローバルウェーハズ株式会社によるトプシルセミコンダクター社半導体事業の譲渡取得合意について

弊社グローバルウェーハズ・ジャパン株式会社の親会社であるグローバルウェーハズ株式会社（台湾台北市場上場会社）および、デンマーク国のトプシルセミコンダクター社（ナスダック・コペンハーゲン市場上場会社）は、グローバルウェーハズ株式会社がトプシルセミコンダクター社のC ZならびにF Zに関わるシリコン半導体事業を3億2千万デンマーククローネで譲渡取得することについて合意しました旨、2016年5月20日に発表いたしました。

本案件は6月17日に予定されているトプシル社の臨時株主総会における承認ならびに中華民国經濟部下の台湾証券投資委員会の承認を経た上で発効します。

本買収手続は7月上旬に完了する見込みです。

トプシルセミコンダクター社は3”～8”のF Z/C Z/Ep i シリコンウェーハ製品ポートフォリオを保有しており、デンマークおよびポーランドに製造拠点を有しております。

トプシルセミコンダクター社のF Zウェーハは、インフラならびにエネルギー産業に広く用いられる高中耐圧半導体デバイスの基板として広く使われております。

2015年の売上高は約2億7千万デンマーククローネ（日本円換算約45億円）です。

本事業統合はグローバルウェーハズ社の戦略に沿うものであり、両社の製品群、優れた技術、ならびにシリコンウェーハ業界における地位の統合は顕著なシナジー効果を発揮するものと考えております。

グローバルウェーハズ株式会社によるニュースリリースのリンクは下記の通りです。

<http://www.sas-globalwafers.com/pages/gw/en/news/detail.aspx?ArticleId=4856D8E9FF5242CFB8DEA5886E0C1EF8>

グローバルウェーハズ・ジャパン株式会社
管理部

以上